

证券代码： 300219

证券简称：鸿利智汇

鸿利智汇集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2026 年 9 月 15 日（周二）下午 14:30~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长/总裁李俊东 2、副总裁/董事会秘书/财务总监赵军
投资者关系活动主要内容介绍	问：请问金舵投资现在对公司有没有靠谱的大力支持，比如寻找优质资产注入。 您好,控股股东金舵投资自入主以来,持续在公司治理规范、国资资源对接、产业协同、资本赋能等多方面给予公司支持。 战略层面,金舵投资支持公司坚定落地“一体两翼”产业发展战略,共同设立战略创业投资基金,围绕 LED 先进封装、Mini/Micro LED、汽车照明及电子、泛半导体、精密制造等战略性新兴产业领域挖掘、培育优质产业项目,为上市公司储备潜在产业资源,助力主业做强、前沿赛道布局。 治理与管理层面,依托国资治理经验,持续推动公司内控体系完善、管理效能提升,规范上市公司治理,强化风险管控,夯

	实经营管理基础。 产业与客户层面，发挥国资平台产业链资源优势，积极对接上下游产业生态，协助公司拓展优质客户、挖掘产业协同机会，优化客户与业务结构。 资本与信用层面，依托控股股东国资信用背书，公司外部信用条件得到改善，融资渠道进一步拓宽，融资成本实现显著优化，有效增强公司资金保障能力，支撑业务持续投入。谢谢。 问：请结合公司目前的生产情况和现阶段的股价你认为如何为股东创造收益？如果公司发展战略不适合未来发展前景是否考虑转型？谢谢！ 您好，二级市场股价受宏观环境、行业周期、市场情绪等多重因素影响，短期股价波动并不完全等同于公司内在价值。公司将坚定不移落实“一体两翼”产业发展战略，同时前瞻布局前沿赛道；持续优化产品结构、优质客户结构，提质增效、改善经营基本面，通过扎实的经营业绩夯实公司内在价值，努力为股东创造长期回报。 公司当前发展战略是结合行业趋势与自身产业基础制定，将会动态评估战略落地成效，持续优化业务布局。谢谢。 问：望公司及时更新，微信公众号，及时介绍公司经营动态，让投资者多了解公司产品！ 您好，感谢您的宝贵建议。公司官方微信公众号“鸿利智汇”一直在持续更新，发布公司经营动态、市场活动、产品技术等信息，涵盖 LED 半导体封装、汽车照明、Mini/Micro LED 显示等核心业务，便于投资者了解公司相关情况。 后续公司也会继续做好公众号运营，进一步向大家展示公司产品与业务进展。感谢您对公司的关注与支持！ 问：请问三季度业绩预告，何时出？是否有大幅增长？ 您好，根据创业板上市公司信息披露相关规则，三季度业绩预告不属于强制披露事项。公司 2026 年三季度业绩情况请留意
--	--

后续披露的 2026 年三季度报告相关内容。谢谢！

问：公司定增十年来，已跌破定增价近百分之五十，请问何时才能回到定增价？作为科技公司，目前是否有什么产品能提高公司利润？

您好，公司将持续推进“一体两翼”业务布局：以半导体封装为基础支撑，以汽车照明及电子、Mini/Micro 新型显示两大业务为增长引擎。半导体封装主业上，会强化技术与产业链整合，优化产品和客户结构，加速布局健康智能照明、植物照明、影视照明、汽车照明等高附加值赛道，巩固车规支架优势；汽车照明板块持续开发客户、推进项目落地，拓展国内外乘用车、商用车车灯市场；Mini/Micro LED 方面，着力构筑直显领域核心客户体系，推动标准化产品向中型客户市场深度渗透，实现市场份额稳步提升。除此之外，公司将在深耕现有主业的基础上，积极拓展新增长曲线，聚焦人工智能、半导体、汽车电子等前沿技术领域开展战略布局。

同时，二级市场股价受宏观环境、行业周期、市场情绪等多重因素影响，请注意投资风险。谢谢。

问：公司于 2016 年-2017 年，共定增 12 亿，定增价 12.67 元-12.81 元，当时是怎样定价的？十年来跌破定增价近百分之五十，公司有何措施提高市值？定增资金投入生产了吗，何时产生效益，才能达到定增价上方？

您好，2016 年 1 月 27 日，公司非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核获得通过。本次发行的股票数量为 56,634,996 股，发行价格为 12.81 元/股，发行募集资金总额为 725,494,298.76 元，募集资金净额为 710,881,633.91 元。募集资金用于“SMD LED 建设项目”、“收购良友五金 49%股权并增资项目”和“补充流动资金项目”三个项目。具体情况可详见当时的《发行情况报告书》相关章节的内容。

下一步，公司将持续推进“一体两翼”业务布局：以半导体

	封装为基础支撑，以汽车照明及电子、Mini/Micro 新型显示两大业务为增长引擎。在深耕现有主业的基础上，积极拓展新增长曲线，聚焦人工智能、半导体、汽车电子等前沿技术领域开展战略布局。同时，公司会持续优化业务结构、加大技术研发、拓展优质客户，夯实经营基本面，努力提升内在价值回报广大投资者。谢谢。
附件清单(如有)	无
日期	2026-09-15